

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】特表 2004-530015 (P2004-530015A)

【公表日】平成 16 年 9 月 30 日 (2004.9.30)

【年通号数】公開・登録公報 2004-038

【出願番号】特願 2002-583525 (P2002-583525)

【国際特許分類第 7 版】

C 0 9 J 7/02

B 3 2 B 27/28

C 0 9 J 11/00

C 0 9 J 201/00

【F I】

C 0 9 J 7/02 Z

B 3 2 B 27/28

C 0 9 J 11/00

C 0 9 J 201/00

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 4 月 22 日 (2005.4.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

上下両表面区域を備え、基材組成物が 85 ~ 100 重量%の架橋したエチレン重合体を含む基材組成物層と、

基材組成物層の下部表面区域に付着する接着剤組成物層と、を含む単一の厚みを持つ温度耐性テープ。

【請求項 2】

架橋したエチレン重合体が、ポリエチレン、低密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレンおよび高密度ポリエチレンを含む群から選択される少なくとも 1 つである、請求項 1 記載のテープ。

【請求項 3】

基材組成物が、エチレン酢酸ビニル、エチレンメチルアクリレート、エチレン酢酸ブチル、エチレンエチルアクリレート、エチレンアクリルエラストマーおよびエチレンアクリル酸を含む群から選択される少なくとも 1 つの共重合体をさらに含む、請求項 1 記載のテープ。

【請求項 4】

基材組成物が、天然または合成ポリイソプレン、エチレンプロピレンゴム、ジエンターポリマー、ブチルゴムおよびスチレンブタジエンを含む群から選択される少なくとも 1 つのエラストマーをさらに含む、請求項 1 記載のテープ。

【請求項 5】

架橋したエチレン重合体がシラングラフトによって架橋されている、請求項 1 記載のテープ。

【請求項 6】

基材層組成物が 0.2 から 3.0 重量%のシランをさらに含む、請求項 1 記載のテープ

。

【請求項 7】

基材層組成物が 0.2 から 1.8 重量 % のシランをさらに含む、請求項 1 記載のテープ。

。

【請求項 8】

基材層組成物が、加工助剤、熱安定剤、酸化防止剤、触媒、顔料、難燃剤および充填材を含む群から選択される少なくとも 1 つの添加剤をさらに含む、請求項 1 のテープ。

【請求項 9】

接着剤組成物層が感圧接着剤または半感圧接着剤を含む、請求項 1 記載のテープ。

【請求項 10】

接着剤組成物が架橋されている、請求項 9 記載のテープ。

【請求項 11】

接着剤組成物層が、ブチルゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリイソブレン、スチレンイソブレンスチレン、スチレンブチルスチレンまたはスチレンエチレンブチルスチレンを含む群から選択されたもののうち少なくとも 1 つを含む、請求項 9 記載のテープ。

【請求項 12】

請求項 1 記載の接着剤層が、粘着付与樹脂、可塑剤、加硫剤、安定剤、難燃剤、殺菌剤、充填材、触媒および顔料を含む群から選択される添加剤をさらに含む、請求項 9 記載のテープ。

【請求項 13】

接着剤組成物層および基材組成物層がハロゲンフリーである、請求項 1 記載の温度耐性テープ。

【請求項 14】

上下両表面区域を持ち、基材組成物が 85 ~ 100 重量 % のシラン架橋した低密度ポリエチレン重合体を含む基材組成物層と、

基材組成物層の下部表面区域に付着し、接着剤組成物が感圧接着剤または半感圧接着剤を含む接着剤組成物層と、を含む単一の厚みを持つ温度耐性テープ。

【請求項 15】

基材組成物層が、85 から 90 重量 % のシラン架橋した低密度ポリエチレン重合体を含む、請求項 14 記載の温度耐性テープ。

【請求項 16】

接着剤組成物が架橋されている、請求項 14 記載のテープ。

【請求項 17】

基材組成物層および接着剤組成物層が実質的にハロゲンフリーである、請求項 14 記載の温度耐性テープ。

【請求項 18】

上下両表面区域を持ち、基材組成物が少なくとも 85 から 90 重量 % の架橋した低密度ポリエチレン重合体を含む基材組成物層と、

基材組成物層の下部表面区域に付着し、接着剤組成物が架橋結合感圧接着剤を含む接着剤組成物層とを含み、

基材組成物層と接着剤組成物層とが実質的にハロゲンフリーであることを特徴とする単一の厚みを持つ温度耐性テープ。

【請求項 19】

上下両表面区域を持ち、基材組成物が 85 ~ 100 重量 % の架橋可能なシラングラフトポリエチレン重合体を含む基材組成物層と、

基材組成物層の下部表面区域に付着し、接着剤組成物が感圧接着剤または半感圧接着剤を含み、架橋可能なポリエチレン重合体を硬化させる触媒をさらに有する接着剤組成物層と、を含む単一の厚みを持つ温度耐性テープ。

【請求項 20】

125 を越える温度において構造的および化学的完全性を維持する、請求項1、14、18または19記載の温度耐性テープ。

【請求項21】

氷点下40 から180 の温度範囲にわたって構造的および化学的完全性を維持する、請求項1、14、18または19記載の温度耐性テープ。

【請求項22】

表面区域を持つ基質と、その基質表面に付着した請求項1、14、18または19記載の温度耐性テープとを含む製造品。

【請求項23】

温度耐性保護テープの製造方法であって、

- a. 85～100重量%の架橋可能なエチレンを基にした重合体樹脂および触媒を含有する基材組成物を、選択された温度にある上部ロールと選択された温度にある中央ロールの間を通して、第一カレンダーニップへ選択された温度にて押し出し成形する工程と、
 - b. 選択された温度にある中央ロール上で基材組成物層を形成する工程と、
 - c. 選択された温度にある接着剤組成物を、選択された温度にある中央ロールと選択された温度にある下部ロールの間を通して、第二カレンダーニップへ選択された温度で押し出し成形する工程と、
 - d. 基材組成物層および接着剤組成物層を含むテープをワンステップカレンダー処理により形成し、それにより接着剤組成物を基材組成物層に直接カレンダー仕上する工程と、
 - e. 架橋可能なエチレンを基にした重合体樹脂を反応させて基材組成物内に架橋を形成する工程と、
- を含む方法。

【請求項24】

温度耐性保護テープの製造方法であって、

- a. 85～100重量%の架橋可能なエチレンを基にした重合体樹脂を含有する基材組成物を、選択された温度にある上部ロールと選択された温度にある中央ロールの間を通して、第一のカレンダーニップへ選択された温度にて押し出し成形する工程と、
 - b. 選択された温度にある中央ロール上で基材組成物層を形成する工程と、
 - c. 架橋させるための触媒を含む接着剤組成物を、選択された温度にある中央ロールと選択された温度にある下部ロールの間を通して、第二カレンダーニップへ選択された温度で押し出し成形する工程と、
 - d. 基材組成物層および接着剤組成物層を含むテープをワンパスカレンダー処理により形成し、それにより基材組成物層を直接カレンダー上に形成する工程と、
 - e. 架橋可能なエチレンを基にした重合体樹脂を反応させて基材組成物内に架橋を形成する工程と、
- を含む方法。

【請求項25】

周囲の水分が架橋可能な樹脂の反応物質として作用する、請求項23または24記載の方法。

【請求項26】

架橋結合しているエチレンを基にした重合体樹脂がシラン架橋した低密度ポリエチレンである、請求項23または24記載の方法。

【請求項27】

温度耐性保護テープの製造方法であって、

- a. 85～100重量%の架橋可能な重合体樹脂を含む基材層材料を入手する工程と、
 - b. 接着剤が架橋可能な重合体樹脂と反応する触媒を有する接着剤層材料を基材層材料にワンステップカレンダー処理により塗布し、それにより接着剤組成物を基材組成物層に直接カレンダー仕上する工程と、
 - c. 架橋可能な重合体樹脂を反応させて基材層材料内に架橋を形成する工程と、
- を含む方法。

【請求項 28】

温度耐性保護テープの製造方法であって、

- a . 85 ~ 100 重量 % の架橋可能な重合体樹脂を含む基材層材料を入手する工程と、
 - b . 接着剤層材料を基材層材料にワンステップカレンダー処理により塗布し、それにより接着剤組成物を基材組成物層に直接カレンダー仕上する工程と、
 - c . 架橋可能な重合体樹脂を反応させて基材層材料内に架橋を形成する工程と、
- を含む方法。

【請求項 29】

架橋可能なエチレンを基にした重合体樹脂がシラン架橋可能な低密度ポリエチレンである請求項 27 または 28 記載の方法。

【請求項 30】

周囲の水分が架橋可能な樹脂の反応物質として作用する、請求項 27 または 28 記載の方法。

【請求項 31】

製造方法が実質的にハロゲンフリーである、請求項 27 または 28 記載の方法。